

la lettre arcsis

PROVENCE - ALPES- CÔTE D'AZUR AVR. 2006 - N°18 - PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL D'INFORMATION

EDITO

Réussir Tous ensemble



« Rassemblement des forces », « Innovation » constituent les maîtres mots de la Ville de Rousset depuis des années. La politique de labellisation des pôles de com-

petitivité qui vise à soutenir l'innovation et lutter contre la concurrence internationale rejoint totalement notre démarche.

En garantissant l'ancrage national de notre industrie, le pôle mondial « Solutions Communicantes Sécurisées » (SCS) va encourager les complémentarités régionales, focaliser la recherche et le développement sur les marchés de pointe et réduire le temps de commercialisation des innovations, par l'accentuation du maillage Formation, Recherche et Industrie.

Coordinateur « des actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements », le Conseil Régional PACA a mis en place une forte politique de soutien aux entreprises afin de favoriser l'essor des activités industrielles nouvelles ou existantes et de renforcer plus encore l'emploi et l'attractivité de notre territoire.

Suite à la labellisation du pôle SCS, la Région s'est engagée pour la zone de Rousset à hauteur de 12,3 millions d'euros d'aides à la recherche et aux entreprises. A ce jour, 7,5 millions ont été déjà débloqués, 2,8 millions d'euros supplémentaires le seront en 2006. En matière de recherche, la Région a par ailleurs lancé un appel à candidatures pour soutenir les projets des laboratoires scientifiques et des jeunes chercheurs.

Plus largement, l'Assemblée Plénière du 31 mars 2006 a acté les subventions pour les 8 pôles implantés en PACA. Le lancement d'un appel à projets pour 4 millions d'euros a débouché sur le dépôt de 71 dossiers de candidature. ARCSIS confirme son rôle majeur au service de la composante microélectronique du pôle SCS, notamment à travers la labellisation d'une vingtaine de projets.

Je souhaite une pleine réussite à ARCSIS et au pôle SCS car leur succès sera aussi celui de la commune de Rousset, du Pays d'Aix, du département et de la région.

Jean-Louis CANAL

Maire, Conseiller Régional, Vice-Président de la Communauté du Pays d'Aix.

L'ÉVÉNEMENT

CONFÉRENCE MONDIALE « IMPLANTATION IONIQUE »

Une opportunité de valorisation pour le savoir-faire régional

L'édition 2006 de la Conférence IIT (Ion Implant Technology) se tiendra à Marseille du 12 au 16 juin prochain. Considérée comme la rencontre de référence dans les technologies d'implantation ionique, elle réunira, aux côtés des acteurs de la région, les plus grands spécialistes mondiaux de l'industrie et de la recherche.

Proposée en 1954 par William Shockley, l'implantation ionique s'est imposée comme une technologie-clé dans la fabrication des composants électroniques. Destinés à bombarder les plaques de silicium avec des ions (atomes chargés d'électricité) très fortement accélérés par des champs électriques, les équipements industriels d'implantation ionique (implanteurs) représentent un marché de plus de 2 milliards d'euros par an. Tous les deux ans, les plus grands spécialistes mondiaux se réunissent en Europe, aux Etats-Unis ou en Asie, pour faire le point sur toutes les avancées de cette technique de dopage des semi-conducteurs, des aspects les plus fondamentaux de l'interaction ion-solide jusqu'aux applications industrielles et au développement des machines. Du 12 au 16 juin 2006, c'est Marseille qui accueillera, dans le cadre prestigieux du palais du Pharo, la Conférence Internationale sur l'Implantation Ionique (IIT).

Le choix de la cité phocéenne pour cette 16ème édition revient au Comité International de la Conférence IIT. En octobre 2004, cette institution a accepté la proposition d'Arcsis, des universités d'Aix-Marseille et de la société IBS, à Rousset, porteuses de la candidature. Ce congrès de référence mondiale, né en 1977, attirera plus de 600 participants issus d'entreprises et de laboratoires d'une trentaine de pays. Lors de la précédente édition, les trois quarts provenaient de l'industrie, un quart du monde académique. Préalablement à la conférence, entre le 8 et le 10 juin, les meilleurs spécialistes du secteur formeront les nouveaux venus aux sciences et techniques de l'implantation ionique.

Pour Arcsis, assurer la bonne tenue de cet événement constitue à la fois une reconnaissance de son rôle et un défi de taille dans la mesure où l'association se voit offrir une opportunité exceptionnelle de mettre en avant le savoir-faire et le potentiel de Pro-

vence-Alpes-Côte d'Azur dans l'utilisation et le devenir de ces technologies. STMicroelectronics ou Atmel abritent plusieurs équipements de production et la R&D se montre particulièrement active grâce aux collaborations entre IBS et les laboratoires TECSEN, L2MP, CRMCN, l'Institut Fresnel ou LPIIM. Arcsis pourra également valoriser son apport au pôle de compétitivité mondial « Solutions Communicantes Sécurisées ».

La Conférence IIT explorera diverses thématiques telles que la mise au point des équipements et procédés pour la fabrication des composants électroniques du futur, l'exploration de nouvelles applications de l'implantation ionique en optique, en mécanique, les process de dopage et de contrôle... Les besoins des industriels des semi-conducteurs et les solutions apportées par les équipementiers feront l'objet d'un large échange. Enfin, un espace d'exposition dédié aux services et matériels d'implantation ionique se tiendra pendant toute la durée de la manifestation. Toutes les informations relatives au programme de l'événement sont accessibles sur le site internet www.iit2006.com.

Panneau de contrôle d'un implanteur ionique R&D



Trois projets de R&D dans les starting-blocks

Sur les neuf candidatures issues de l'appel à projets lancé par ARCSIS en 2005, trois ont finalement bénéficié d'une labellisation.

Le Comité Stratégique d'Arcsis s'est prononcé en février 2006. Suite à l'appel à projets initié par l'association en 2005, trois dossiers se sont vus accorder la double labellisation Arcsis et pôle de compétitivité « Solutions Communicantes Sécurisées ». La décision découle d'un long processus d'analyse et de réflexion qui avait admis l'éligibilité potentielle de cinq des neuf propositions initialement présentées. Les trois projets sélectionnés ont été déposés à la Région, afin d'obtenir les financements publics complémentaires nécessaires à leur réalisation.

Le premier d'entre eux réunit le laboratoire L2MP et la société Orsay Physics sur le thème : « Couplage des techniques de faisceaux d'ions focalisés (FIB) et d'épitaxie (MBE : Molecular Beam Epitaxy) ». Il a pour but de créer une centrale de nanotechnologie (basée sur la nanolithographie par faisceau d'ions silicium) et de nanoélaboration (épitaxie par jet moléculaire) unique en Europe. Cet équipement entièrement sous ultra-vide et localisé dans un environnement salle blanche, permettra de fabriquer et mettre en oeuvre des structures innovantes dédiées à la réalisation d'objets technologiques. Divers projets de collaboration avec les universitaires et industriels locaux appelés à utiliser ce nouvel outil sont en cours de dépôt.

Le second projet labellisé porte sur l'« assemblage de nouveaux nanomatériaux catalytiques sur plate-forme silicium ». Il regroupe le laboratoire L2MP (UMR CNRS 6137 et Université du Sud Toulon-Var), les sociétés IBS à Rousset (13) et CESIGMA à La Garde (83). Objectif : concevoir de nouveaux systèmes de détection de gaz mettant en jeu une grande diversité de composants catalytiques nanostructurés au sein de systèmes miniaturisés. Ce marché des « nez électroniques » affiche une expansion continue depuis plus de 10 ans.

Enfin, le laboratoire LP3 et la société aixoise In Silicio s'investissent sur le 3ème projet, baptisé « Faisabilité d'Outils TCAD (Technology Computer Aided Design) prédictifs pour les procédés BEOL (Back-end of line) de métallisation au-delà de 65 nm ». Grâce à des simulations par dynamique moléculaire, il s'agit de développer des modèles de croissance des couches minces à l'échelle atomique, capables de prédire les propriétés des dépôts en fonction des conditions du procédé. Cette étude répond aux besoins prioritaires de l'industrie des semi-conducteurs pour 2008-2010.

Arcsis souligne la qualité et le caractère innovant de ces projets et souhaite remercier les experts et les rapporteurs qui ont travaillé à leur analyse, garantissant ainsi la valeur de la labellisation par le Comité Stratégique. Bonne chance aux porteurs de projets !

Un ellipsomètre bientôt disponible

La plate-forme Caractérisation du CIM PACA réalisera prochainement un ellipsomètre. Les enjeux de ce projet ont été présentés le 7 février dernier par Atmel, STMicroelectronics et la société Sopra au Centre Microélectronique de Provence, à Gardanne.

Ce workshop « ellipsométrie », organisé par POPSud, avait attiré une trentaine d'entreprises et laboratoires des filières optique-photonique et microélectronique, susceptibles de collaborer sur le sujet. Il a également permis de rapprocher les adhérents d'Arcsis de leurs homologues de POPSud (Pôle Optique Photonique Sud). Enfin, des contacts ont été pris pour s'assurer de la pleine utilisation à terme de l'équipement.

L'Intelligence Economique, levier de la création de valeur

Comment bien comprendre les enjeux de l'intelligence économique ? Par le jeu ! ARCSIS, en partenariat avec STUniversity, a proposé à une vingtaine de cadres dirigeants d'entreprises de la filière « Microélectronique et Objets communicants »*, un « Business Game » alternant mises en situation simulées, formation et coaching sur la pratique de l'intelligence économique dans un contexte industriel fortement compétitif. Les retours ont été très positifs, notamment sur la qualité des simulations de la gestion d'entreprise, les présentations des outils de veille et les échanges grands groupes - PME.

Cette action, soutenue financièrement par la DRIRE et le SGAR, vise à mutualiser et valoriser des informations stratégiques en vue d'accélérer l'émergence et le montage de projets à forte valeur ajoutée au sein d'ARCSIS et des plates formes de CIM PACA. Elle entre dans le cadre du schéma régional d'Intelligence Economique et préfigure ce qui pourrait être déployé dans le pôle Solutions Communicantes Sécurisées.

*STMicroelectronics, Gemplus, Europe Technologies, NBS, One RF, SPS, Tagsys...

Vincent BOISARD
vincent.boisard@arcsis.org

Conception

Une soixantaine de personnes, industriels, académiques et institutionnels, ont pris part le 17 mars dernier à l'assemblée générale, puis à l'inauguration de la plate-forme Conception, au sein de l'Ecole Polytechnique Universitaire (EPU), à Sophia Antipolis. Après l'adoption du règlement intérieur, du budget prévisionnel et des cotisations pour 2006 lors de l'AG, cette manifestation conviviale a permis de rappeler l'historique, le fonctionnement, les projets et les modules de base de la plate-forme.



De g. à d. : Pierre Bricaud (Synopsys), Christian Pichot (Directeur de Recherche CNRS et Président de la Plate-Forme CIM PACA), Bruno Delepine (Philips et Directeur opérationnel de la Plate-Forme), Nathalie Cottat (Philips), Erich Palm (ATMEL et Président d'ARCSIS)

Caractérisation

Le 10 février dernier à Gardanne, devant les représentants de l'Etat, l'Association Caractérisation a présenté officiellement son projet ARTHEMIS (Actions de Recherche sur les Technologies HÉTÉROGÈNES à Mémoires Intégrées Sécurisées). La plate-forme a obtenu 6M€ de fond public destiné à l'investissement en équipements de recherche qui seront utilisés dans le cadre de ce projet. Les équipements de recherche académique à vocation industrielle (FIB, TEM, SEM, XPS, Raman) arriveront mi-2006 et seront installés provisoirement sur la zone de Rousset. STMicroelectronics hébergera bientôt, également de manière provisoire, les deux premiers équipements industriels de la Plate-forme (le micro-Auger arrivera courant mars, le D-SIMS arrivera fin mai). D'autres équipements industriels arriveront au cours du 2^{ème} semestre.

Micro-Packs

Le 12 avril 2006, la plate-forme MicroPacks clôturera le « projet ARCSIS Jetpac » (labellisé en 2003) en présence d'élus du Conseil Régional et du Conseil Général 13 et du consortium du projet (Gemplus, Cybernetix, Impika, SPS, GCOM2 et CMP-GC). Cette manifestation sera suivie d'une démonstration du moteur d'impression Jetpac et d'une présentation du plan d'action 2006 de la plate-forme.

Machine industrielle JetPac, technologie d'impression par jet de matière pour le micro-assemblage et l'électronique plastique



INNOVATIONS

ABC Smart Card met son savoir-faire au service des plus grands

Société d'ingénierie dans les solutions de contrôle d'accès par carte à puce, avec ou sans contact, ABC Smart Card a conquis en un an à peine des leaders mondiaux dans sa clientèle.

Dans un secteur aussi sensible que la microélectronique, la sécurité des sites industriels implique une vigilance absolue. En un an, les solutions proposées par ABC Smart Card ont su gagner la confiance d'une dizaine de clients dont plusieurs fleurons de la filière : Gemplus, Atmel, Innova Card, Inside Contactless ou Tagsys... La petite société d'ingénierie, créée à Marseille en mars 2005, est née de la recherche permanente de systèmes de sécurité physique et logique toujours plus performants. Fort de son expérience dans les logiciels et applications de la carte à puce, Hervé Abel a pris la tête de l'entreprise, tout en continuant à diriger ABC Indépendants qui met à disposition de



sa clientèle des consultants informatiques pour la réalisation de projets sur-mesure.

ABC Smart Card intervient dans le contrôle d'accès multi-applicatif, en se fondant sur les technologies de la carte à puce avec ou sans contact. Elle propose deux types de logiciels. Les premiers, fournis « clés en mains », ne nécessitent pas de profondes modifications des systèmes informatiques déjà installés : gestion d'accès aux PC, aux locaux, pointeuse numérique... Les seconds sont plus personnalisables pour se plier aux besoins du marché : développement de drivers et d'applications PC/SC, « customisation » de lecteurs de cartes à puce, technologie RFID... Tous répondent aux attentes en matière de lecteur pour carte de fidélité, borne de paiement, gestion d'accès, sécurisation des données...

ABC Smart Card s'appuie sur une équipe d'informaticiens et d'électrotechniciens pour concevoir et installer ses innovations. ABC Smart Card est également membre de l'association Baby Smart.

Christelle Carbonnel Responsable commerciale

Rencontrer donneurs d'ordres ou sous-traitants

FIDEST 2006

Le salon industriel méditerranéen FIDEST aura lieu du 27 au 29 juin 2006 au Parc Chanot de Marseille. Cet événement accueillera 250 exposants et proposera un espace «Convention d'Affaires» où grands donneurs d'ordre français et industriels régionaux pourront tenir leurs rendez-vous.

→ Informations complémentaires : www.fidest.org

Exporter en Amérique du Sud

Mission au Brésil

Une mission d'affaires de grande ampleur rassemblant acteurs économiques, politiques et représentants de tous les secteurs d'activités prépondérants de Provence-Alpes-Côte d'Azur se déroulera à Sao Paulo et Rio de Janeiro, au Brésil, du 30 avril au 6 mai 2006.

→ Renseignements : martine.lecureuil@ccimp.com

Technologies de simulation

Eurosime 2006

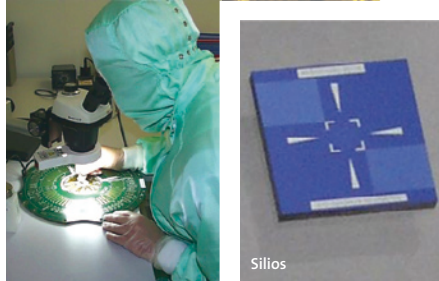
La 7^{ème} conférence internationale sur les simulations thermiques, mécaniques et multi-physiques et expériences en microélectronique et microsystèmes se tiendra du 24 au 26 avril à Como en Italie.

→ Information : www.eurosime.org

NEWS... NEWS... NEWS...

STMMicroelectronics relance ses investissements

Afin de faire face à la reprise de la demande du marché des semi-conducteurs, STMMicroelectronics va investir sur son unité de Rousset 175 millions de dollars dans l'accroissement de 25% de sa capacité de production. A fin 2006, le groupe franco-italien veut fabriquer 7 000 plaquettes de silicium par semaine sur son unité 8 pouces. Cette montée en puissance s'effectuera parallèlement à la réduction de la production de l'usine 6 pouces dont la fermeture est envisagée en deux phases, juin 2006 et juin 2007. STMMicroelectronics emploie à Rousset 3 000 personnes.



Silios Technologies enrichit sa gamme

Spécialisé en microtechnologie optique pour les télécommunications, la transmission de données, l'imagerie, l'instrumentation... et fabricant de microstructures sur silice et silicium à Rousset, Silios Technologies complète sa gamme avec des étalons pour la calibration de dimensions verticales à l'échelle nanométrique (inférieures à 20 nm et jusqu'à 1 nm). Ces produits permettent aux industriels et aux scientifiques de la microélectronique, de l'optique, de la photonique ou des biotechnologies, d'obtenir une meilleure précision de leurs mesures. Ils trouvent leur application dans le domaine de la métrologie, en particulier des microscopes AFM (Atomic Force Microscope) et SPM (Scanning Probe Microscope).

→ Information : www.silios.com

Étalon pour calibration

Le Pic de Bure à la pointe des nanotechnologies

Situés dans les Hautes-Alpes, les 2 552 mètres du Pic de Bure entrent dans l'ère des nanotechnologies. A une telle altitude, il est en effet possible de tester l'incidence des rayonnements cosmiques naturels sur les composants électroniques dix fois plus rapidement qu'au niveau de la mer ! Un atout incomparable pour les industriels et laboratoires désireux de s'assurer de la fiabilité sur le long

terme de leurs technologies de miniaturisation à l'échelle nanométrique des objets communicants sécurisés ou d'imaginer les solutions susceptibles de pallier leurs dysfonctionnements potentiels. La société d'Aix-en-Provence Bertin Technologies a conçu une machine de test des puces, installée au sommet du Pic de Bure au début de l'année pour engager les expérimentations.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Erich Palm, Président d'Arcsis

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Céline Auger

COORDINATRICE DE RÉDACTION

Corinne Joachim

RÉDACTEUR

Eric Collomb

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO

Vincent Boisard, Agnès Bourayne,

Jean-Louis Canal, Christelle Carbonnel,

Nathalie Cottat, Corinne Demée,

Bruno Delepine, Anne-Claire Desneu-

lin, Pascal Galand, Jean-Raymond

Gavarri, Tatiana Itina, Corinne Joa-

chim, Laurent Londeix, Marie-José

Mannini, Catherine Marchand, Katia

Mirohntchenko, Antoine Ronda,

Laurent Roux, Michel Thomas.

PUBLICATION SOUTENUE PAR

Le Conseil Régional Provence-

Alpes-Côte d'Azur, le Conseil

Général des Bouches-du-Rhône,

le Conseil Général du Var, la

Mairie de Rousset, le Ministère

de la Recherche et les adhérents

d'ARCSIS.

CRÉDIT PHOTOS

ABC Smartcard, ARCSIS, IBS,

Mairie de Rousset, Telecom Valley,

STMMicroelectronics,

Silios Technologies.

CRÉATION ET MISE EN PAGE

Etincelles

infos@etincelles-studio.com

IMPRESSION

Espace : 04 91 78 58 78



BP 19, place Paul Borde, 13790 ROUSSET
tél. : 04 42 53 81 50 - fax : 04 42 53 81 51

7^{ÈME} CONFÉRENCE EUROPÉENNE AEC-APC

La compétitivité en marche

Les plus grands groupes européens et mondiaux de la microélectronique se sont retrouvés pour la première fois du 29 au 31 mars 2006 à Aix-en-Provence pour enrichir leurs réflexions sur les contrôles d'équipements et de process avancés (AEC-APC). Plus de 250 experts, principalement européens, mais aussi américains et asiatiques, issus de l'industrie (équipementiers, fabricants de semi-conducteurs...) et de la recherche, ont planché sur les moyens d'améliorer la compétitivité, la qualité et les performances des process de production de circuits intégrés, dans un contexte où les technologies se font de plus en plus complexes, les outils de plus en plus coûteux et les clients de plus en plus exigeants ! Les participants ont pu assister à trente conférences, prendre connaissance de quarante posters et rencontrer une douzaine d'exposants, au Centre de Congrès d'Aix, avant de prolonger leurs échanges dans le cadre convivial de Pont-Royal, à Mallemort. « En discutant très en amont de problématiques de conception et de fabrication qui nous concernent tous et en validant ensemble l'intérêt des solutions techniques proposées, nous préservons la valeur ajoutée de l'industrie microélectronique européenne » souligne Erich Palm, président d'ARCSIS, co-organisateur local avec Atmel et STMicroelectronics. En 2007, Dresde accueillera la 8^{ÈME} édition du 18 au 20 avril, à l'invitation d'AMD et Infineon.



VERBATIM



Laurent Londeix, président de Telecom Valley

« Une communauté de bâtisseurs du futur »

Co-fondatrice du pôle de compétitivité « Solutions Communicantes Sécurisées », Telecom Valley trouve ici l'occasion de se présenter aux adhérents d'ARCSIS.

Laurent Londeix : Telecom Valley est née en 1991 et siège à Sophia Antipolis, première technopole d'Europe. Elle compte 90 membres dont les activités recouvrent toutes les étapes de la chaîne de valeur des sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC) : ingénierie de conception, microélectronique, logiciels, télécommunications, multimédia, applications spatiales, optiques... Représentant un total de 15 000 emplois, Telecom Valley veut apparaître comme la première communauté en Europe à anticiper, développer et promouvoir les usages, services et technologies qui bâtissent le futur des STIC.

Arcsis : Sur quelles modalités fonctionne l'association ?

Laurent Londeix : Telecom Valley réunit les expertises de ses membres, quelle que soit leur taille, start-up, PME, groupes internationaux, ainsi que les centres de recherche et d'enseignement supérieur, les organismes de normalisation, les institutions régionales... Leur implication repose essentiellement sur le bénévolat. Plusieurs commissions (partenaires, emploi, communication, innovation et recherche...) définissent le programme d'actions et de projets. Telecom Valley a notamment lancé Tourism@, une manifestation dédiée aux nouvelles technologies appliquées au tourisme, imaginé KMP (Knowledge Management Platform) qui cartographie les

compétences des membres de l'association, institué un Prix de l'Innovation technologique ou partenariale... Elle est également à l'origine du Challenge Jeunes Pousses où étudiants d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce montent ensemble des projets de création d'entreprise. En matière d'emploi, elle rapproche des cadres demandeurs d'emploi et des entreprises disposant de projets « dormants » afin de les aider à les mettre en œuvre. N'oublions pas, non plus, que Telecom Valley permet chaque année, sur un stand unique, à plusieurs entreprises de présenter leurs produits et innovations au salon international des télécommunications mobiles, 3GSM World Congress.

Arcsis : Comment situez-vous votre rôle par rapport à Arcsis ?

Laurent Londeix : Comme Arcsis, Telecom Valley est co-fondatrice du Pôle de Compétitivité « Solutions Communicantes Sécurisées ». Les deux associations interviennent dans des domaines d'activités complémentaires, principalement télécoms et logiciels pour Telecom Valley, microélectronique et objets communicants pour Arcsis. Mais par dessus tout, nos membres se caractérisent par leur détermination à s'investir dans le devenir de la région !

→ www.telecom-valley.fr

SAME

Le Forum SAME 2006 se tiendra à Sophia Antipolis (06) les 4 et 5 Octobre prochains sur le thème « Complexité du Design et Impact des Applications : Concept, sécurité et basse consommation aujourd'hui et demain ». Les sociétés qui souhaitent disposer d'un stand sur l'événement peuvent réserver dès maintenant. Pour proposer une intervention, les thématiques retenues sont indiquées sur le site internet de la conférence : www.same-conference.org.

Les présentations devront être adressées au plus tard le 2 mai 2006. La meilleure sera récompensée lors du cocktail de clôture, le 5 octobre. Pour toute information complémentaire :

→ **Anne Claire Desneulin**
Tél : 04 92 29 48 31
same@cote-azur.cci.fr

Rencontres Scientifiques et Techniques d'ARCSIS

Les 9^{ÈMES} Rencontres Scientifiques et Techniques d'ARCSIS se tiendront les 16 et 17 novembre 2006 dans les locaux de STUniversity à Fuveau (13). Cet événement rassemble des entreprises et laboratoires français et étrangers sur des sujets pointus répondant aux besoins du marché de la microélectronique. Elles seront consacrées cette année au thème suivant : « Sensibilité des dispositifs avancés aux contaminations ». Les présentations porteront sur les différents types de contaminations et sur leurs conséquences observées au niveau des plaques, des équipements, des systèmes de distribution, des matériaux..., lors de la fabrication et de l'assemblage des circuits. Les orateurs souhaitant faire une présentation (20 mn) doivent adresser à ARCSIS un titre, le nom des auteurs et un résumé d'un demi-page indiquant le problème et l'intérêt des solutions proposées. La date limite de soumission des résumés est le 21 juin 2006.

→ **Contact : Corinne Joachim**
Tél. : 04 42 53 81 50
corinne.joachim@arcsis.org

Journée Micropackaging 2006

Pour la 4^{ÈME} année consécutive, ARCSIS organise des journées techniques et scientifiques dédiées au Micropackaging, un des points forts de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette manifestation, prévue du 23 au 24 novembre 2006, s'adresse aux industriels et scientifiques nationaux et internationaux oeuvrant dans le domaine du microassemblage pour l'électronique. Les conférences, d'une durée de 25 mn incluant 5 mn de questions, traiteront en particulier d'Électronique plastique et de Packaging souple. Les participants souhaitant effectuer une présentation doivent adresser à ARCSIS un titre et un résumé d'environ 10 lignes, le vendredi 16 juin 2006 au plus tard.

→ **Contact : Corinne Joachim**
Tél. : 04 42 53 81 50
corinne.joachim@arcsis.org